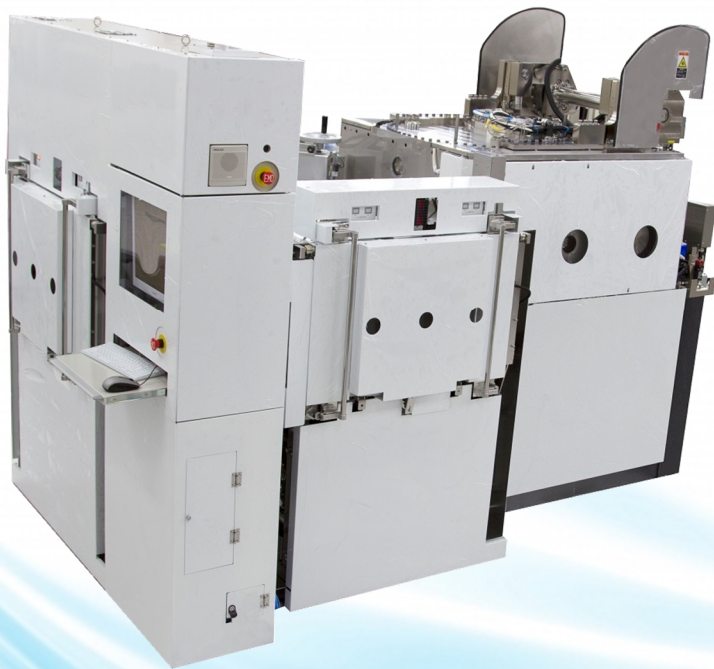


超高真空下で量産を実現

Realization of large volume production under ultra high vacuum



優れた再現性

Excellent repeatability

Φ6インチ、Φ4インチ対応

Compatibility for 6inch and 4inch wafer

1組3.5分の高い生産性*1

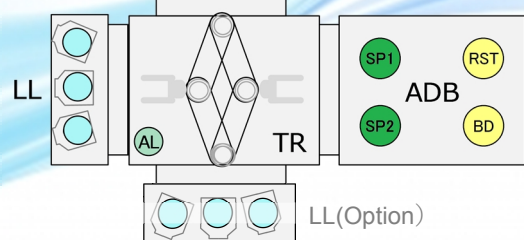
High productivity of 3.5 min. for 1 set of bonding

*1: 接合基板材料、条件によります。

原子拡散接合装置 BC7000

Atomic Diffusion Bonding Equipment BC7000

システム構成図
System configuration diagram



用語：LL:Load Lock Chamber / TR:Transfer Chamber / ADB:Atomic Diffusion Bonding Chamber / AL=Aligner / SP=Sputtering Holder / BD=Bonding Stage / RST=Rotary Substrate Table

ボイドフリー接合と位置合わせ技術

Void free bonding and alignment technologies

極薄膜厚の再現性

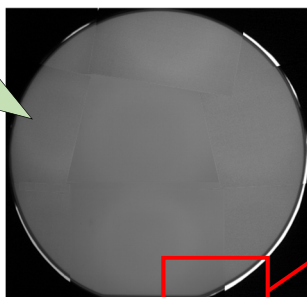
Excellent repeatability with ultra thin film control technology

赤外線透過画像
Infra red transmission image

基板外形でのアライメント
Outside form alignment

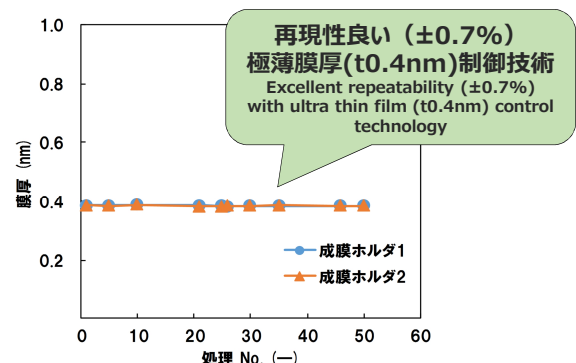
基板中心の膜厚再現性
Film thickness repeatability of the center

極薄膜でもボイドフリー
Void free with ultra thin film



基板アライメント
マーカー不要
Free alignment
marker on the
wafer

基板サイズ：Φ100mm
接合膜：Ti (t1nm)



再現性良い (±0.7%)
極薄膜厚 (t0.4nm) 制御技術
Excellent repeatability (±0.7%)
with ultra thin film (t0.4nm) control
technology